

公司代码：688216

公司简称：气派科技



气派科技股份有限公司
2021 年年度报告摘要

披露日期：2022 年 4 月 19 日

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 重大风险提示
无
- 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 4 公司全体董事出席董事会会议。
- 5 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
是 否
- 7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利4元（含税），以2021年12月31日公司股份总额10,627.00万股测算，共计分配现金股利42,508,000.00元（含税），若至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	气派科技	688216	不适用

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	文正国	王绍乾
办公地址	广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦	广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦
电话	0769-89886666	0769-89886666
电子信箱	IR@chippacking.cn	IR@chippacking.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1. 主要业务

公司自成立以来，一直从事集成电路的封装、测试业务。经过多年的沉淀和积累，公司已发展成为华南地区规模最大的内资集成电路封装测试企业之一，是我国内资集成电路封装测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之一。

公司始终坚持以自主创新驱动发展，注重集成电路封装测试技术的研发创新，通过丰富、齐全的产品种类构筑市场竞争优势。公司掌握了 5G MIMO 基站 GaN 微波射频功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术、小型化有引脚自主设计的封装方案等多项核心技术，形成了自身在集成电路封装测试领域的竞争优势，在集成电路封装测试领域具有较强的竞争实力。

2. 主要产品

公司以集成电路封装测试技术的研发与应用为基础，从事集成电路封装、测试及提供封装技术解决方案。公司封装技术主要产品包括 MEMS、FC、Qipai、CPC、SOP、SOT、LQFP、QFN/DFN、CDFN/CQFN、DIP 等系列共 190 多种产品，能满足更多客户的需求。

公司的产品应用领域主要根据客户芯片的用途来划分，应用于消费电子、信息通讯、智能家居、物联网、汽车电子、工业应用等领域。

(二) 主要经营模式

公司从事集成电路封装、测试并提供封装技术解决方案。公司采购引线框架、丝材、装片胶和塑封树脂等原辅料，按照客户要求对其提供的晶圆芯片进行一系列内部工艺加工以及外协辅助加工。凭借多年积累的封装测试核心技术、经验丰富的人员团队、精密的封装测试设备和精益生产线的优化管理，公司完成芯片封装测试的精密加工后将成品交还给客户，向客户收取加工费，获取收入和利润。

此外，在了解客户需求的基础上，公司会少量采购通用的晶圆，在产能允许时进行封装测试形成芯片成品，在客户有需求时将这些芯片成品销售给客户，从而取得收入及获取利润。客供芯

片封装测试由客户提供晶圆芯片，自购芯片封装测试由公司自行采购晶圆芯片；除此以外，公司的客供芯片封装测试和自购芯片封装测试的采购模式、生产模式、销售模式、研发模式没有差别。

1.采购模式

公司设置采购部、计划部等部门，根据公司生产需要，针对集成电路封装测试加工所需的原材料、辅料、备件、包材等物料进行采购，除此之外，公司还对生产设备、外协加工服务项目进行采购。

2.生产模式

公司作为专业封装测试厂商，致力于为客户提供多样化、针对性、差异化及个性化的封装测试产品与服务，同时通过对生产系统的管理，对生产产品的品种和产量能够快速灵活的调整，形成了以多样化定制生产、快速切换为主的柔性化生产模式。

3.销售模式

公司销售环节采用直销模式，公司客户主要为芯片设计公司。绝大部分芯片设计公司由于本身无晶圆制造环节和封装测试环节，其自身只根据市场需求设计集成电路版图。该等芯片设计公司完成芯片设计后，将其交给晶圆代工厂制造晶圆，晶圆完工后交给公司，由公司对晶圆进行封装测试，之后芯片设计公司将公司封装测试后的集成电路销售给电子整机产品制造商，最后由电子整机产品制造商以电子整机的形式销售给终端消费者。

4.研发模式

公司主要采用自主研发模式，公司设有研发中心，全资子公司广东气派设有技术工程研究中心，主导新技术、新工艺、新产品的研究和开发、新材料验证和导入。根据公司的发展战略和发展目标、承接政府部门的攻关项目、销售部门市场调研、客户定制等确定研发项目，经内部立项、设计和开发、反馈和纠正、产品试制、小批量试生产等阶段完成研发工作。公司也通过产学研、企业间合作等方式进行合作研发模式。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 所处行业

公司主营业务为集成电路的封装测试，根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 修订版），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）下属的集成电路制造业（C3973），具体细分行业为集成电路封装测试业。

（2）行业发展阶段及基本特点

集成电路是 20 世纪 50 年代发展起来的一种半导体微型器件，是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等特定加工工艺，按照一定的电路互联，把晶体管、电阻、电容、电感等电子元器件及连接导线，全部集成在微型硅片上，构成具有一定功能的电路，然后封装成电子微型器件，成为能执行特定电路或系统功能的微型结构。

集成电路封装测试包括封装和测试两个环节，因测试业务主要集中在封装企业中，通常统称为封装测试业。封装是指对通过测试的晶圆进行背面减薄、划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋成型等一系列加工工序而得到独立的具有完整功能的集成电路的过程。封装的目的是保护芯片免受物理、化学等环境因素造成的损伤，增强芯片的散热性能，以及便于将芯片端口联接到部件级（系统级）的印制电路板（PCB）、玻璃基板等，以实现电气连接，确保电路正常工作。测试主要是对芯片或集成模块的功能、性能等进行测试，通过测量、对比集成电路的输出响应和预期输出，以确定或评估集成电路元器件的功能和性能，其目的是将有结构缺陷以及功能、性能不符合要求的产品筛选出来，是验证设计、监控生产、保证质量、分析失效以及指导应用的重要手段。

集成电路产业诞生于美国，并迅速在欧洲、日本、韩国等地发展起来，但是随着产业的技术进步和市场发展，封装测试环节的产能已逐渐由美、欧、日等地区转移到中国台湾、中国大陆、新加坡、马来西亚和菲律宾等亚洲新兴市场区域。中国台湾地区是最早兴起集成电路专业封装测试代工模式的地区，也是目前全球最大的集成电路封装测试基地，中国大陆位居其次。

集成电路下游应用广泛，涵盖消费电子、电力电子、交通、医疗、通讯技术、医疗、航空航天等众多领域。近年来，随着物联网、人工智能、云计算、大数据、5G、机器人等新兴应用领域的蓬勃发展，各类集成电路产品的使用场景和用量不断增长，为集成电路产业注入了新的增长动力。2021 年全球半导体市场高速增长。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2021 年全球半导体销售达到 5,559 亿美元，同比增长 26.2%。中国仍然是最大的半导体市场，2021 年的销售额总额为 1,925 亿美元，同比增长 27.1%。

2021 年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势，2021 年中国集成电路产业首次突破万亿元。根据中国半导体行业协会统计，2021 年中国集成电路产业销售额为 10,458.3 亿元，同比增长 18.2%。其中，设计业销售额为 4,519 亿元，同比增长 19.6%；制造业销售额为 3,176.3 亿元，同比增长 24.1%；封装测试业销售额 2,763 亿元，同比增长 10.1%。

2021 年中国集成电路产品进出口都保持较高增速。根据海关统计，2021 年中国进口集成电路

6,354.8 亿块，同比增长 16.9%；进口金额 4,325.5 亿美元，同比增长 23.6%。2021 年中国集成电路出口 3,107 亿块，同比增长 19.6%，出口金额 1,537.9 亿美元，同比增长 32%。

（3）主要技术门槛

集成电路封装测试行业属于技术密集型行业，摩尔定律反映了封装测试技术更新换代快的特征。半导体行业摩尔定律指出，单位面积芯片上集成的晶体管数每隔 18 个月增加一倍，其背后驱动力是行业对高性能、低功耗芯片的不断需求，并导致芯片不断小型化，同时从降低芯片流片成本、节约电路板空间考虑也要求芯片面积缩减。

随着先进节点走向 7nm、5nm、3nm，研发生产成本持续走高，投资金额呈指数级增加，良率下降，晶圆制造成本增加，摩尔定律趋缓，半导体行业逐渐步入后摩尔时代。然而晶圆制造制程不会无限缩小下去，晶体管也不可能无限增加下去，因此，封装技术已成为超越摩尔定律的关键赛道。

封测企业需要不断进行技术创新、开发新产品才能适应市场变化，顺应集成电路下游应用市场集成化、小型化、智能化的发展趋势。封装领域不断涌现出新兴封装类型以及先进封装技术，这对于封装测试企业在新产品的研发和测试方面提出了苛刻的要求，技术门槛越来越高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在集成电路直插封装和贴片封装产品领域具有较强的成本控制和质量管理优势，是国内封装测试技术应用型代表企业之一。公司在产品质量、交货期、专业服务等方面赢得了客户的高度认可。2021 年公司集成电路封装年销量达到 103.70 亿只，营业收入达到 80,936.37 万元。公司已发展成为华南地区技术工艺先进、产品系列相对齐全、产销量规模最大的内资集成电路封装测试企业之一。根据中国半导体行业协会封测分会发布的《2021 年中国封测产业发展报告》显示，公司在“2020 年中国本土集成电路封装测试代工企业营收排名”中位列第 9 名。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来，在国家政策扶持以及市场应用带动下，中国集成电路产业保持快速增长，继续保持增速全球领先的势头。2021 年，集成电路设计、制造业、封测业均呈两位数的增长，其中设计和制造业增幅较大，而集成电路设计、制造规模的持续较高增长，将推动封测产业发展

随着半导体制程工艺已接近瓶颈，以及芯片架构优化的限制，未来几年处理器性能的发展将逐步减慢，摩尔定律也将逐渐失效。因此，先进封装将的技术应用成为提高芯片性能的一种重要途径，芯片性能的提升又会促进计算机、IT 产业的发展，从而间接地为芯片设计、制造、封测技

术突破带来更多可能。因此，封装行业发展将带动产业正向循环，意义重大，行业具有十分广阔的发展前景。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	1,845,210,003.48	1,042,233,303.32	77.04	848,088,329.19
归属于上市公司股东的净资产	1,001,531,733.33	545,722,984.43	83.52	470,334,205.63
营业收入	809,363,651.36	548,004,476.71	47.69	414,468,603.20
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	780,135,447.65	529,367,395.14	47.37	/
归属于上市公司股东的净利润	134,587,375.05	80,370,028.80	67.46	33,730,969.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,392,737.92	74,587,791.14	69.45	29,459,982.38
经营活动产生的现金流量净额	221,364,733.96	57,532,669.99	284.76	19,030,906.55
加权平均净资产收益率(%)	17.30	15.83	增加1.47个百分点	7.38
基本每股收益(元/股)	1.45	1.01	43.56	0.42
稀释每股收益(元/股)	1.45	1.01	43.56	0.42
研发投入占营业收入的比例(%)	6.87	6.39	增加0.48个百分点	6.64

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)

营业收入	152,677,498.96	213,540,892.84	227,831,690.05	215,313,569.51
归属于上市公司股东的净利润	20,229,253.70	47,809,823.25	41,264,697.56	25,283,600.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,257,656.82	46,629,928.57	39,813,379.43	20,691,773.10
经营活动产生的现金流量净额	39,909,539.45	32,736,693.14	36,866,916.41	111,851,584.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)								8,684
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								8,135
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)								不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)								不适用
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
梁大钟	0	51,150,000	48.13	51,150,000	51,150,000	无	0	境内 自然 人
白璜	0	10,800,000	10.16	10,800,000	10,800,000	无	0	境内 自然 人

华创证券—兴业银行—华创证券气派科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,657,000	2,657,000	2.50	2,657,000	2,657,000	无	0	境内非国有法人
童晓红	0	2,650,000	2.49	2,650,000	2,650,000	无	0	境内自然人
深圳市创新投资集团有限公司	0	2,300,000	2.16	2,300,000	2,300,000	无	0	国有法人
北京昆石天利投资有限公司—宁波昆石天利股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,300,000	2.16	2,300,000	2,300,000	无	0	境内非国有法人
施保球	0	2,000,000	1.88	2,000,000	2,000,000	无	0	境内自然人
杨国忠	0	1,500,000	1.41	1,500,000	1,500,000	无	0	境内自然人
深圳市昆石投资有限公司—深圳市昆石创富投资企业(有限合伙)	0	1,500,000	1.41	1,500,000	1,500,000	无	0	境内非国有法人
兴贵投资有限公司	1,328,500	1,328,500	1.25	1,328,500	1,328,500	无	0	境内非国有法人

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>1.上述前十名股东持股情况中，公司实际控制人梁大钟和白璞是夫妇关系，合计持有公司 58.29%股份；华创证券—兴业银行—华创证券气派科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划中梁大钟占 33.92%的份额；宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙）和深圳市昆石创富投资企业（有限合伙）均为监事会主席控制的企业，合计持有公司 3.58%股份；兴贵投资有限公司为华创证券有限责任公司全资子公司，其他无关联关系。2.公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。</p>
<p>表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</p>	<p>不适用</p>

存托凭证持有人情况

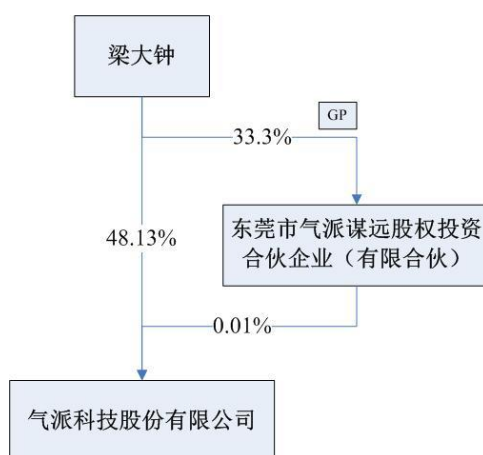
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

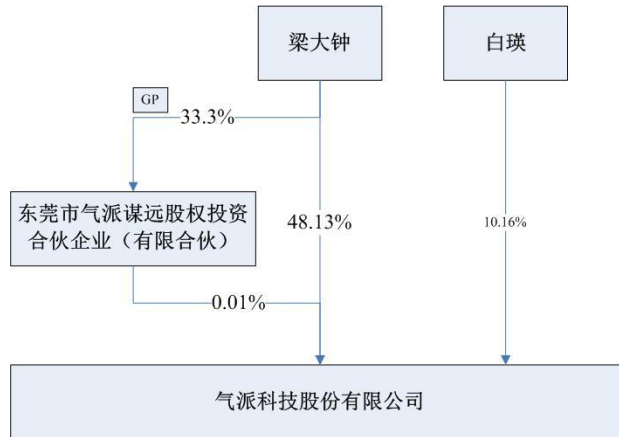
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入 80,936.37 万元，同比增长 47.69%；公司归属上市公司股东的净利润为 13,458.74 万元，同比增长 67.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,639.27 万元，同比增长 69.45%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用